



台积电Q1营收再创新高，全球半导体设备市场保持增长态势

半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年04月13日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

- 分析师：张璐
- SAC编号：S1050526010002
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

台积电Q1营收同比大涨45.2%，再创历史新高纪录

在2025年四季度法说会上，台积电给出的今年一季度营收指引是在348至358亿美元之间，按中间值计算，环比增长4%、同比增长38%。在1美元兑31.6元新台币的汇率条件下，台积电预计今年一季度的新台币营收介于10,996亿至11,312亿新台币之间，按中间值计算，同比增长4.4%，毛利率在63%到65%之间，营业利益率在54%至56%之间。

4月10日，晶圆代工龙头大厂台积电公布了2026年3月营收报告，业绩超出去年指引，营收为新台币4,151.91亿元，环比增长30.7%，同比增长45.2%，再创历史新高纪录。累计1至3月营收约为新台币11,341.03亿元，同比增长35.1%，也同步创下了历史新高纪录。

2025年全球半导体设备市场：中国大陆支出居第一，中国台湾增速最高

国际半导体产业协会（SEMI）发布最新报告称，2025年全球半导体制造设备销售额达到1351亿美元，较2024年的1171亿美元增长15%，连续第三年创下历史新高。这一数据较SEMI在2025年12月发布的1330亿美元预测值上修了约1.6%，反映出AI需求在2025年四季度末仍保持超预期增长态势。

从全球各主要区域的表现来看，2025年半导体设备支出仍集中在亚洲，中国大陆、中国台湾和韩国合计占全球市场的79%，而2024年这一比例为74%，集中度进一步提升。具体来说，2025年，中国大陆的半导体设备支出仍接近历史高位，达到493亿美元，较2024年仅下降0.5%，中国大陆芯片制造商继续投资成熟节点并选择性布局先进产能。中国台湾的半导体设备支出同比大涨90%，达到了创纪录的315亿美元，反映出AI和高性能计算驱动的产能扩张。

建议关注：天数智芯、芯原股份、海光信息、中芯国际。

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-04-10 股价	EPS			PE			投资评级
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E	
688981.SH	中芯国际	101.01	0.46	0.63	0.77	219.59	160.33	130.62	未评级
688347.SH	华虹公司	121.61	0.22	0.22	0.64	552.77	552.77	190.88	未评级
9903.HK	天数智芯	314.8	5.45	-3.98	-1.78	57.76	-79.10	-176.85	买入
688041.SH	海光信息	231.82	0.83	1.09	1.99	279.30	212.68	116.55	未评级
688521.SH	芯原股份	248.00	-1.20	-1.00	0.42	-206.67	-248.00	587.68	未评级

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期，港股股价和EPS货币单位为港元）

目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、周涨幅排行

4月6日-4月10日当周，海外龙头总体呈上涨态势。其中，英特尔领涨，涨幅为23.82%，高通涨幅最小，为0.99%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

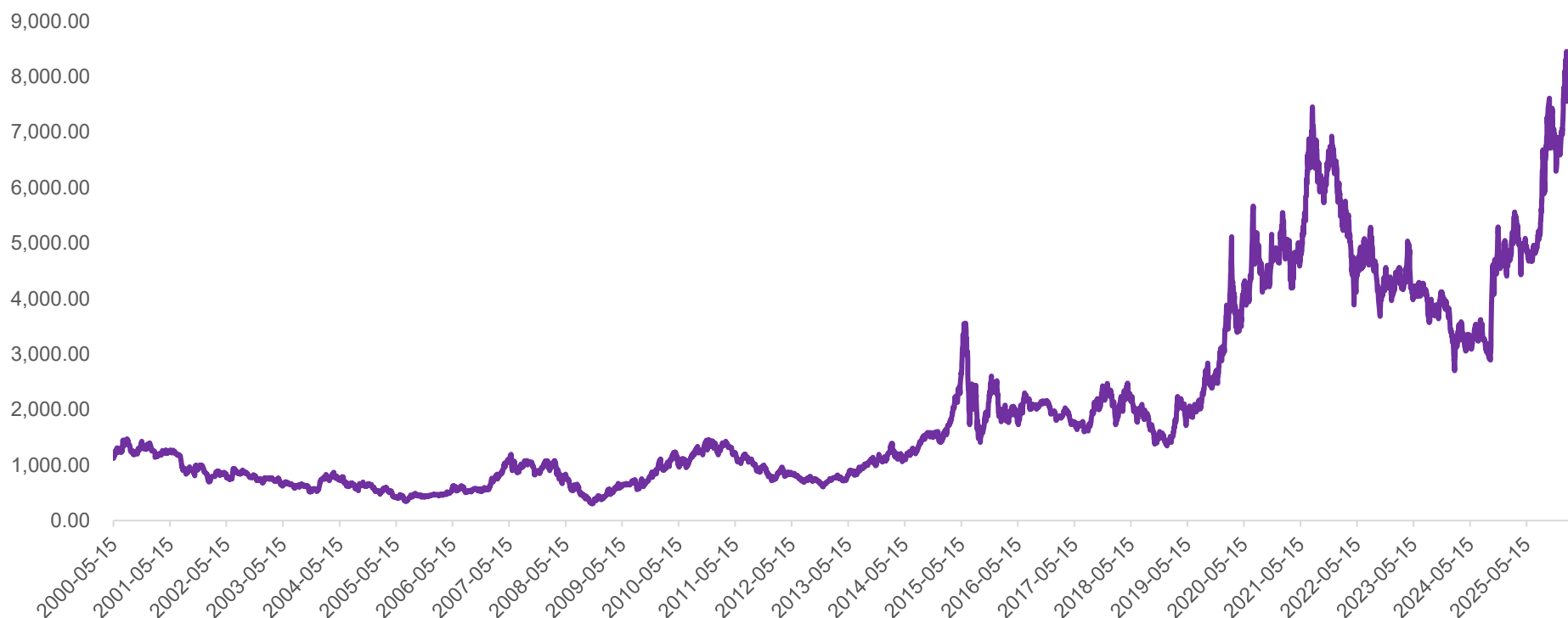
	证券代码	证券简称	国家/地区	市值(亿元)	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅(%)
处理器	INTC.0	英特尔(INTEL)	美国	3132.11	-1173.07	2.74	23.82
	QCOM.0	高通(QUALCOMM)	美国	1366.40	24.66	5.92	0.99
	AMD.0	超威半导体(AMD)	美国	3994.98	92.16	6.34	12.66
	NVDA.0	英伟达(NVIDIA)	美国	45837.09	38.18	29.14	6.34
存储	MU.0	美光科技(MICRON TECHNOLOGY)	美国	4743.14	55.55	6.55	14.84
模拟	TXN.0	德州仪器(TEXAS INSTRUMENTS)	美国	1955.04	39.31	12.01	10.19
	ADI.0	亚德诺(ANALOG)	美国	1709.40	75.39	5.06	9.99
	AVGO.0	博通(BROADCOM)	美国	17591.66	76.07	22.02	18.12
	NXPI.0	恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	516.43	25.55	5.14	5.05
射频	SWKS.0	思佳讯(SKYWORKS)	美国	84.77	17.77	1.47	2.12
	QRVO.0	QORVO	美国	73.95	132.96	2.00	1.41
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	350.89	211.38	1.97	15.03
	ON.0	安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)	美国	270.02	223.16	3.52	10.39
光学	IFX.DF	英飞凌科技	德国	556.37	54.81	3.19	9.92
	3008.TW	大立光	中国台湾	3083.12	14.49	1.63	7.94
半导体设备	AMAT.0	应用材料(APPLIED MATERIAL)	美国	3170.39	45.30	14.60	14.64
	LRCX.0	拉姆研究(LAM RESEARCH)	美国	3292.51	61.45	32.45	20.70
	KLAC.0	科天半导体(KLA)	美国	2277.17	56.07	41.66	14.53
	ASML.0	阿斯麦	荷兰	5821.92	51.71	25.34	12.23
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	2345.15	32.07	2.51	19.78
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	613207.25	30.19	9.57	10.50
	GFS.0	格芯(GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	268.66	30.36	2.25	11.84
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	1967.08	116.13	4.73	23.40
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	553.16	42.86	5.02	11.49
分销	ARW.N	艾睿电子(ARROW ELECTRONICS)	美国	80.81	14.15	1.23	8.46
	AVT.0	安富利(AVNET)	美国	54.87	22.84	1.11	8.34

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

4月6日-4月10日当周，申万半导体指数整体呈现上升的态势。4月10日，申万半导体指数为7614.14，周涨幅为10.49%。

图表3：近5年申万半导体指数

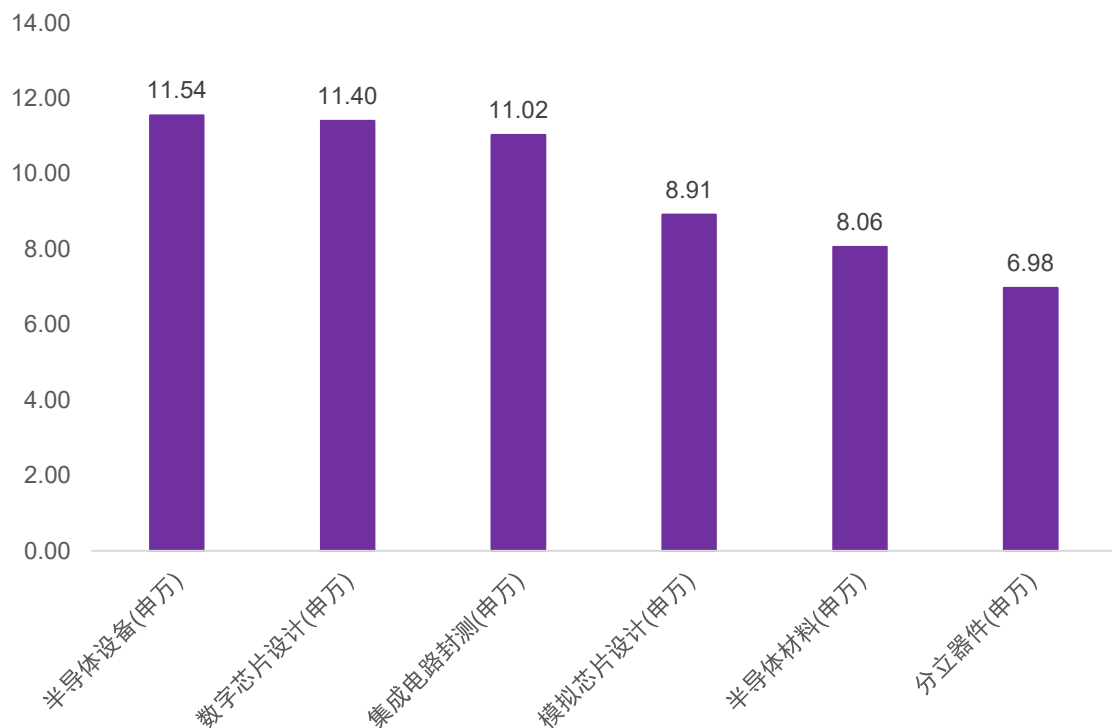


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

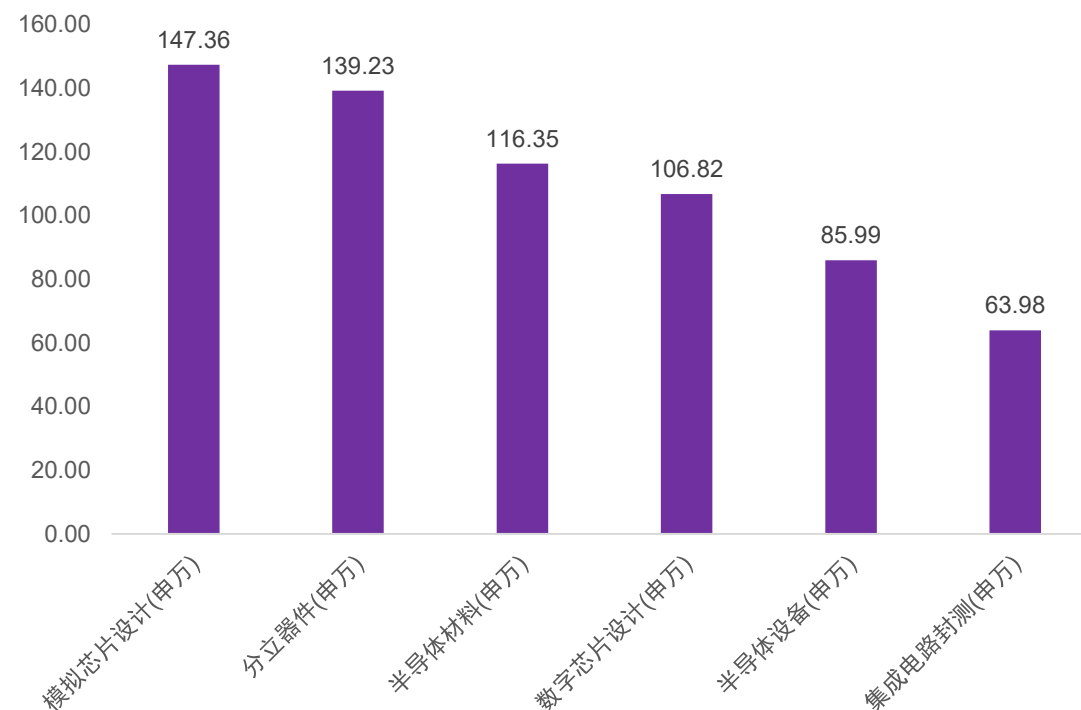
1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，4月6日-4月10日当周，半导体细分板块呈上涨态势。其中，半导体设备板块涨幅最大，达到11.54%；分立器件板块涨幅最小，达到6.98%。估值方面，模拟芯片设计，分立器件，半导体材料板块估值水平位列前三。

图表4：4月6日-4月10日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：4月10日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：

消费电子板块主力净流入65.53亿元，主力净流入率为2.03%，在9个二级子行业中排第1名；航天装备板块主力净流出9.92亿元，主力净流入率为-2.65%，在9个子行业中排第9名。

图表6：4月6日-4月10日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW消费电子	12754742.93	12099437.27	655305.6561	2.03	3
SW其他电源设备II	2945724.323	2786178.587	159545.7365	1.91	3
SW其他电子II	3570741.603	3437529.05	133212.5542	1.47	1
SW计算机设备	4323074.33	4166279.93	156794.4005	1.19	4
SW通信设备	39812268.8	38869351.76	942917.0436	1.14	-2
SW半导体	35055732.73	34759489.07	296243.6577	0.36	4
SW电子化学品II	3130891.908	3129735.226	1156.683	0.01	-1
SW军工电子II	4507379.558	4780695.162	-273315.6049	-2.00	-2
SW航天装备II	878638.2894	977851.8553	-99213.5662	-2.65	1

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

4月6日-4月10日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：锆威特，联动科技，大为股份，德明利，晶升股份，杰华特，盛科通信-U，长川科技，江波龙，利扬芯片，周涨幅分别为：43.79%，27.35%，27.28%，27.05%，24.20%，23.90%，22.57%，20.04%，19.52%，18.29%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值 (亿元)	EPS			PE			PB	周涨跌幅 (%)
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
688693.SH	锆威特	59.77	-1.32	-	-	-0.97	-	-	7.52	43.79
301369.SZ	联动科技	113.69	0.29	-	-	0.18	-	-	7.52	27.35
002213.SZ	大为股份	80.44	-0.20	-	-	-0.48	-	-	14.77	27.28
001309.SZ	德明利	1014.54	2.36	3.15	4.57	3.51	5.10	7.39	31.92	27.05
688478.SH	晶升股份	49.65	0.39	-	-	0.54	-	-	3.29	24.20
688141.SH	杰华特	289.96	-1.35	-	-	-6.11	-	-	19.01	23.90
688702.SH	盛科通信-U	873.30	-0.17	-0.06	0.13	-0.68	-0.25	0.54	39.13	22.57
300604.SZ	长川科技	875.81	0.73	1.27	1.74	4.67	7.98	10.90	20.08	20.04
301308.SZ	江波龙	1430.54	1.20	1.24	-	5.05	5.13	-	19.00	19.52
688135.SH	利扬芯片	69.21	-0.31	-	-	-0.59	-	-	4.40	18.29

资料来源：wind，华鑫证券研究

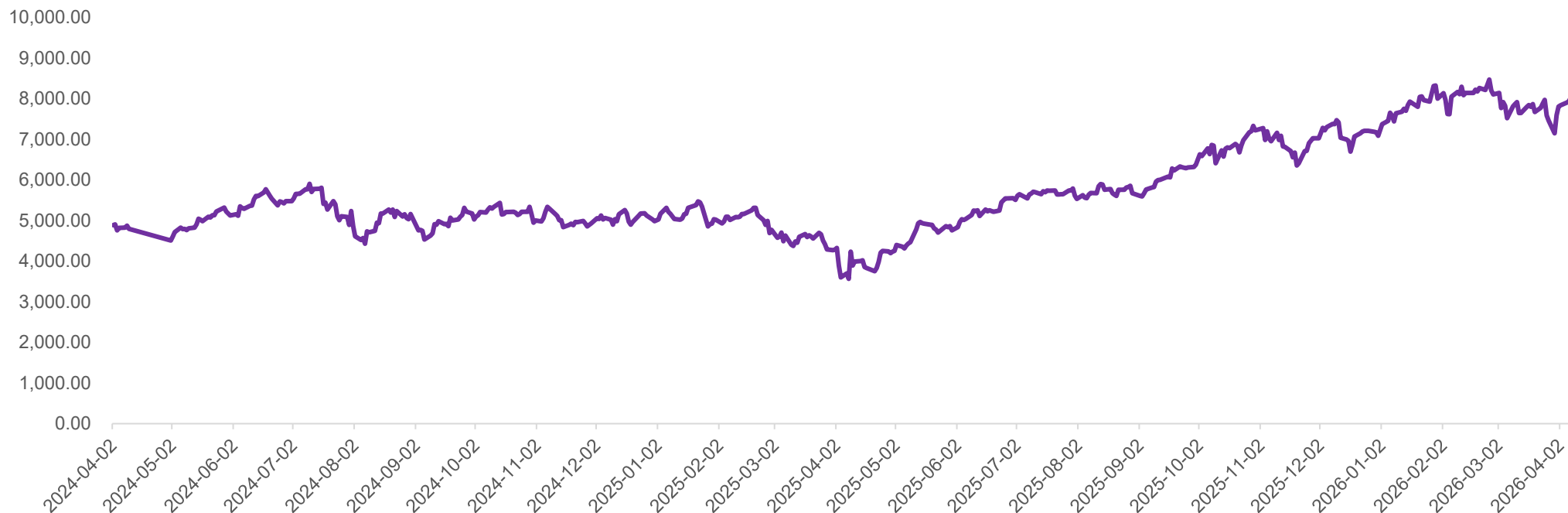
02 行业高频数据

研究创造价值

2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，4月6日-4月10日当周，费城半导体指数总体呈现上涨的态势。更长时间维度上来看，2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，之后呈现震荡上行的态势。

图表8：费城半导体指数近两年走势

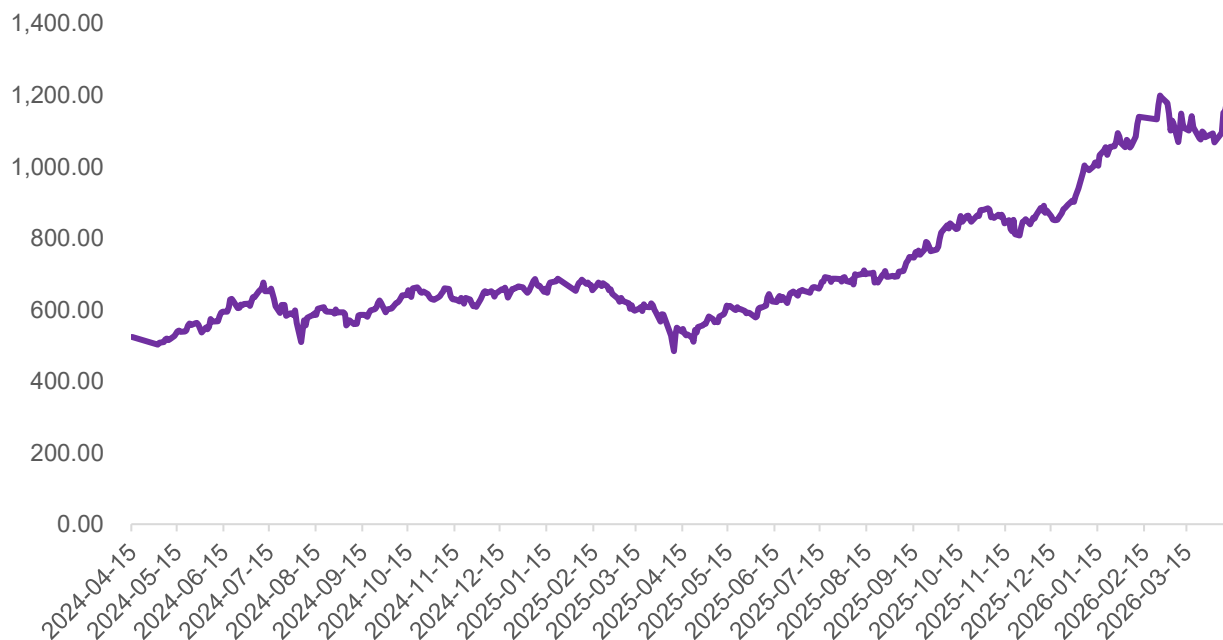


资料来源：wind，华鑫证券研究

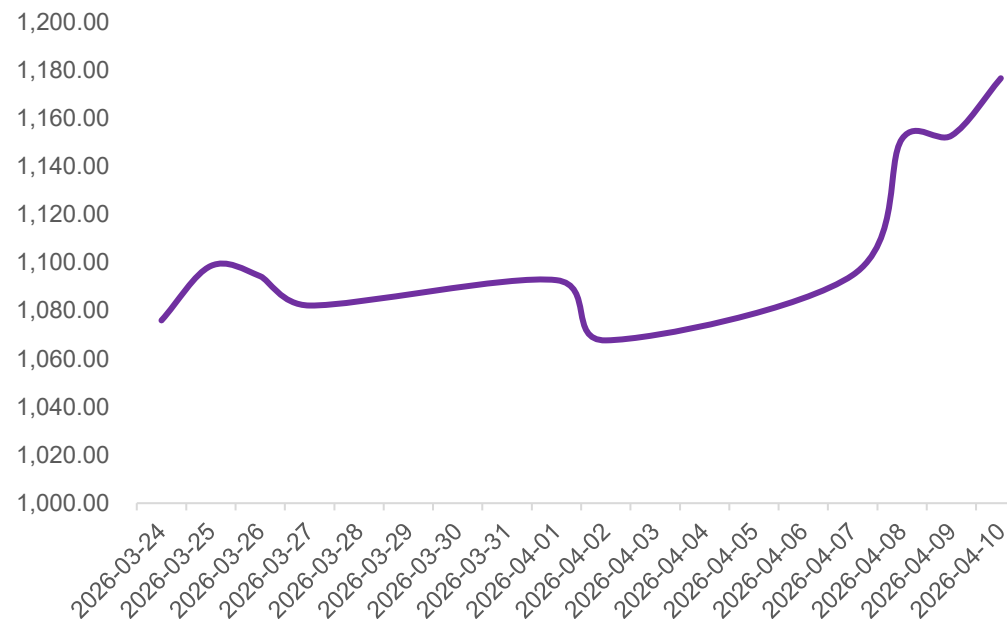
2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，3月30日-4月10日两周，台湾半导体行业指数呈现整体上升的态势。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的趋势。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势

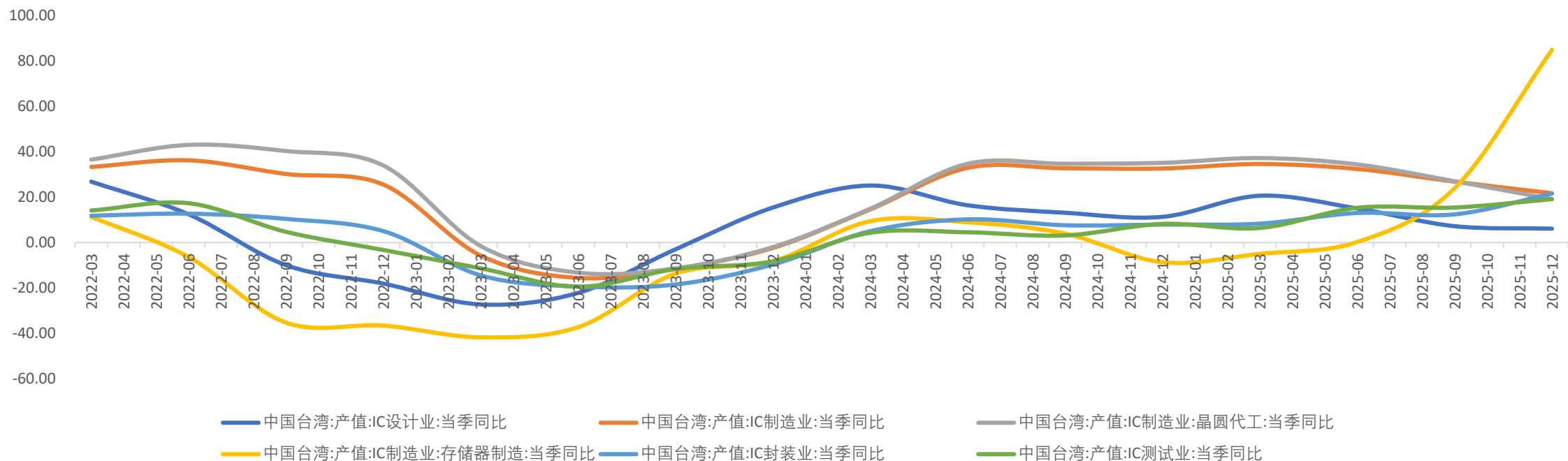


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致IC设计下滑，加之2021年缺货、涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）

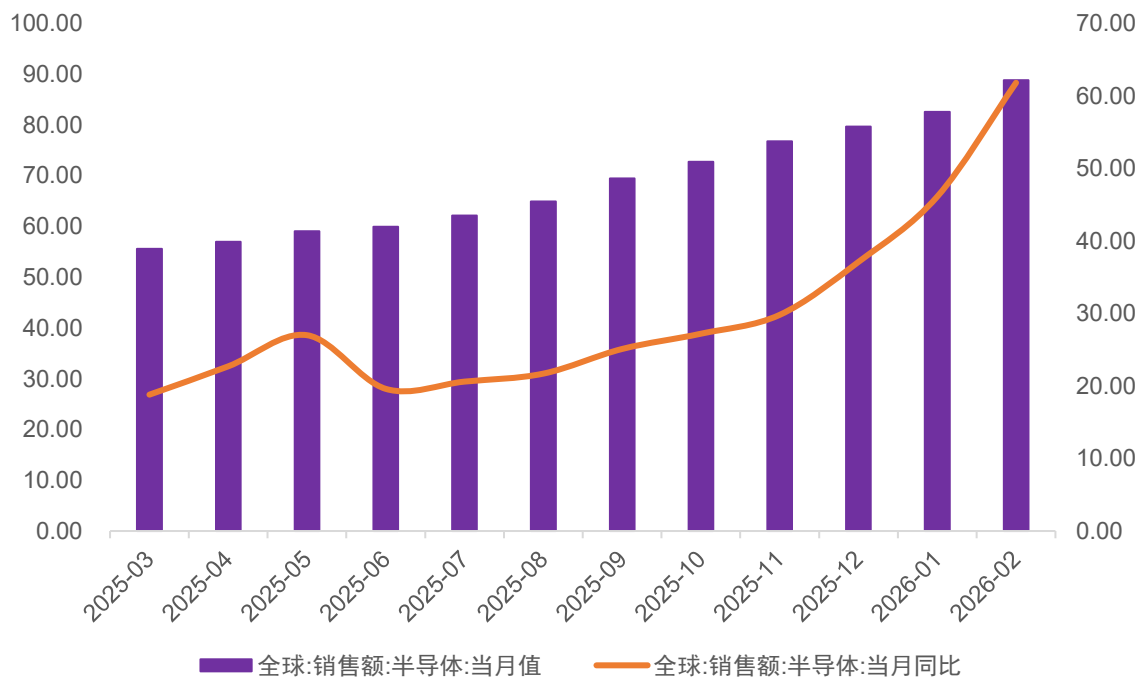


资料来源：wind，华鑫证券研究

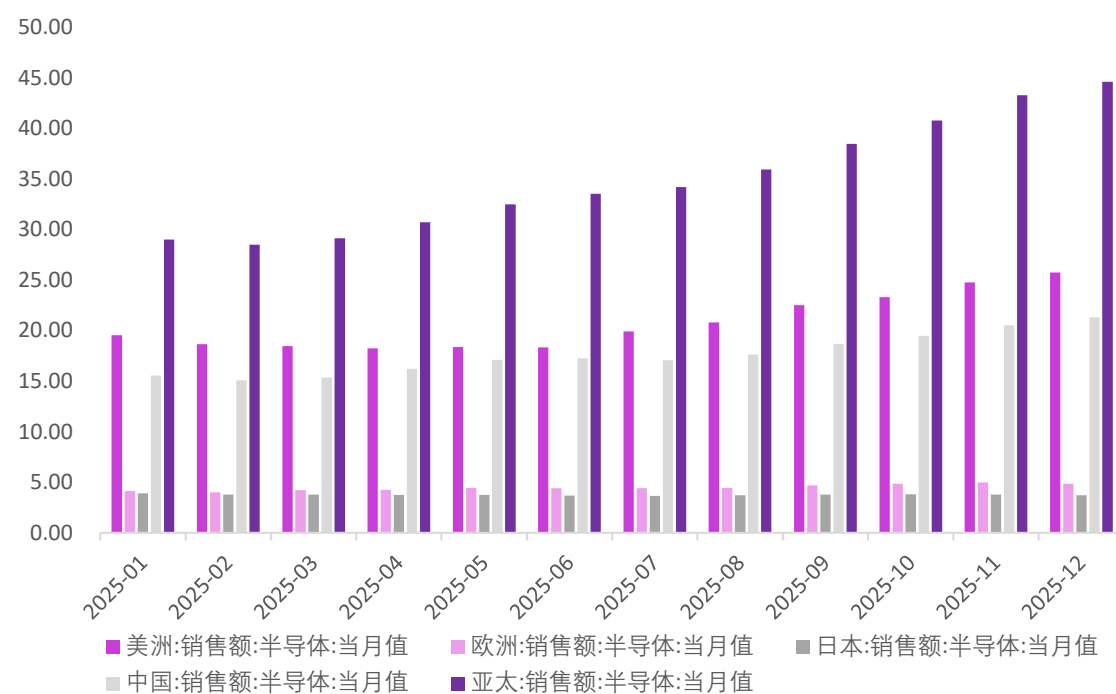
2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年2月，全球半导体当月销售额为887.8亿美元，同比增长61.8%。其中，中国销售额为236.3亿美元，环比增长3.55%，占比达26.62%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

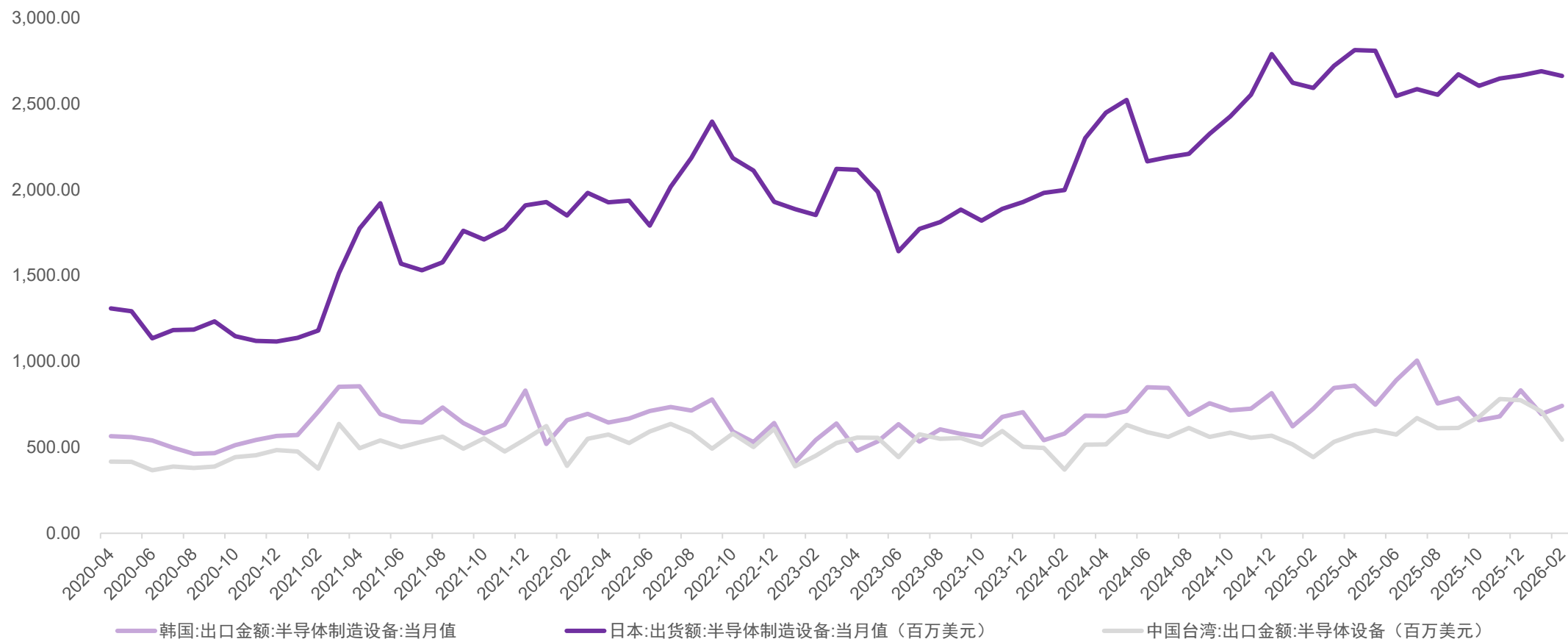


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

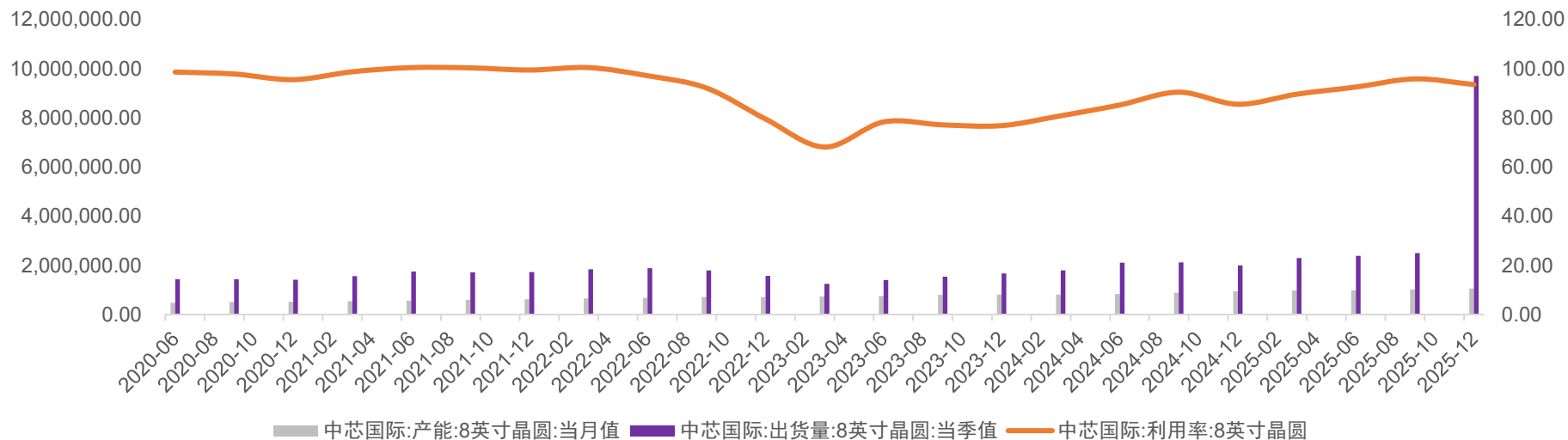
2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2025年12月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约105.9万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020-2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第四季度已恢复至93.5%的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025年第四季度达到近970万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。

整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）

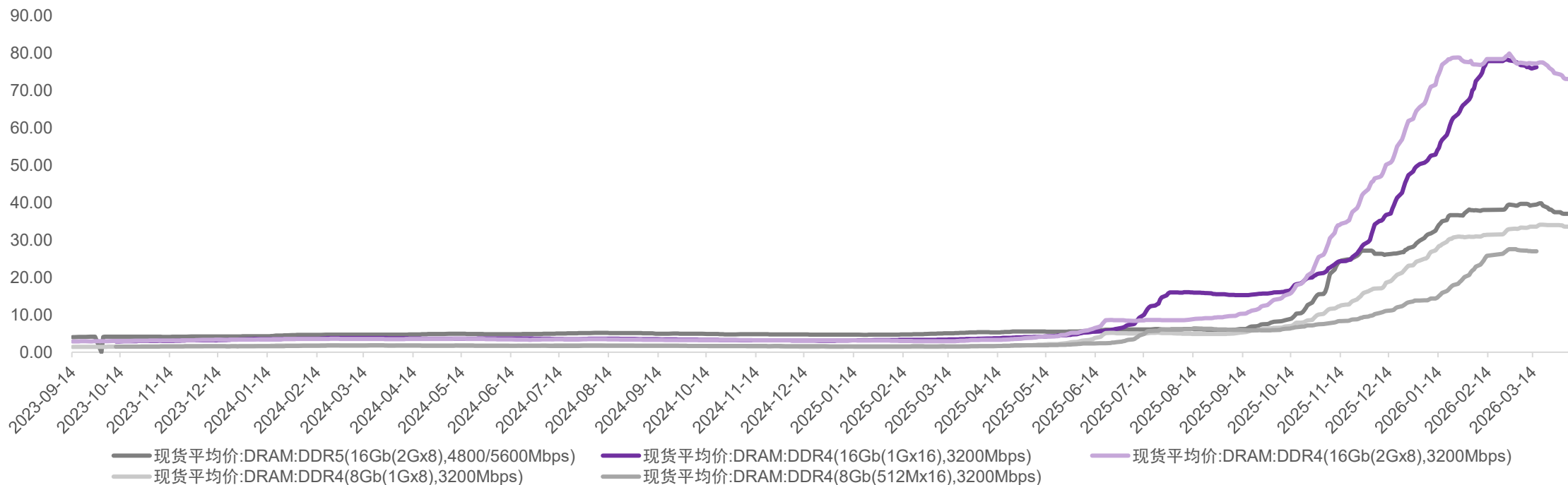


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI算力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年4月以来趋于平稳，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年3月30日价格为22.16美元。DRAM方面：DRAM:DDR5(16Gb(2Gx8),4800Mbps)现货均价从2024年3月以来价格小幅上涨，9月之后又重回下跌态势，2025年1月以来呈现大幅上涨的态势，12月初出现小幅下跌，之后开始进入加速上涨阶段。2026年4月10日价格为37.03美元。

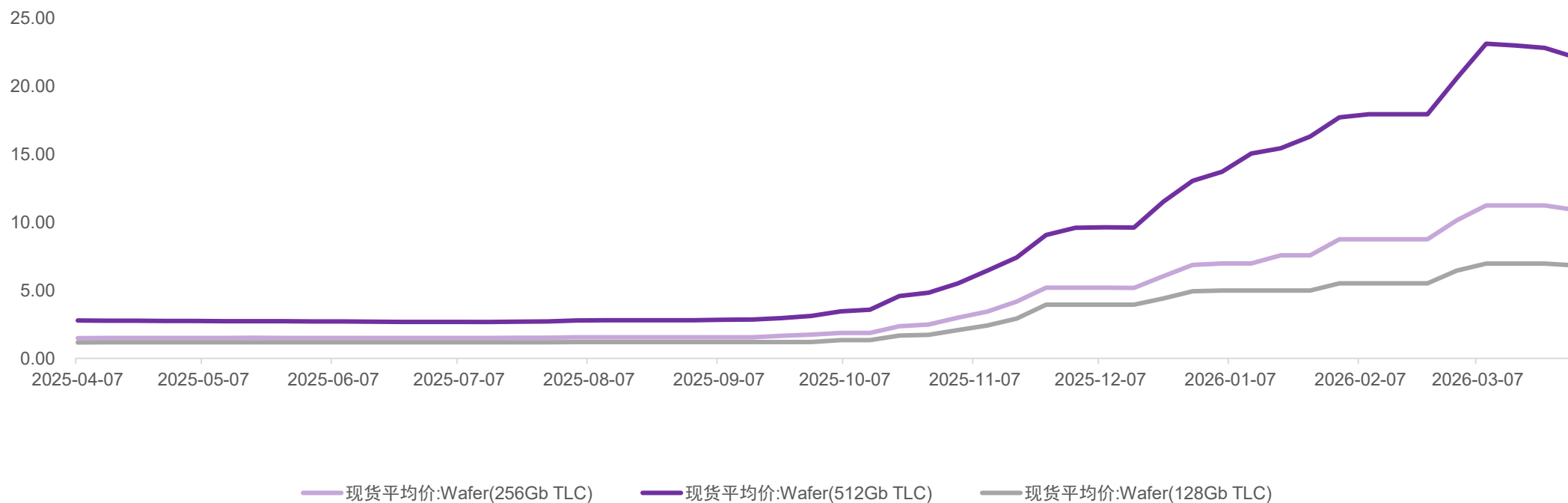
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

03 行业动态

研究创造价值

■ 积塔半导体与英飞凌签署项目合作协议

近日，积塔半导体在上海举办2026半导体技术创新研讨会。

在该次研讨会上，积塔半导体与英飞凌正式签署项目合作协议，双方将围绕嵌入式非易失存储等领域深化技术协作，共同推动特色工艺代工能力升级。

据介绍，在存储技术布局方面，积塔半导体已形成eFlash、SONOS、RRAM三条路线并行，为客户提供多元化选择。此次引入的SONOS技术，以其工艺兼容性好、集成成本低、量产数据充分的特点，进一步丰富了积塔在高可靠且成本敏感场景下的解决方案。依托持续完善的工艺体系，积塔可向客户提供“存储+控制+驱动+功率”的一站式代工服务，实现从单一工艺优势到方案化平台能力的跃升。

公司官网显示，积塔半导体是专注于半导体集成电路芯片特色工艺的研发和生产制造基地。公司在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区和徐汇区建有两个厂区，已建和在建产能共计30万片/月（折合8英寸计算），其中6英寸7万片/月、8英寸12万片/月、12英寸6万片/月、碳化硅1万片/月，为汽车电子、工业控制和高端消费电子领域提供微控制器、模拟电路、功率器件、传感器等核心芯片特色工艺制造平台和技术服务。公司拥有一流的技术研发团队，以及近40年车规级芯片制造质量管理和规模量产经验，公司现有员工4700余人。

中国团队研发，新型高性能二维半导体材料获重要突破

国防科技大学与中科院金属研究所联合团队在二维半导体晶圆级生长及可控掺杂领域取得突破，成果发表于《国家科学评论》。针对二维半导体因晶格缺陷导致自发电子掺杂和费米能级钉扎、长期存在N型多P型少且P型性能差的结构性失衡问题，研究团队建立了以液态金/钨双金属薄膜为衬底的化学气相沉积方法，实现了晶圆级、掺杂可调的单层 WSi_2N_4 （氮化钨硅）薄膜可控生长，使单晶区域尺寸达亚毫米级，生长速率较现有文献提升约1000倍。该材料兼具高空穴迁移率、高开态电流密度、高强度、良好散热性及化学稳定性，综合性能在同类二维材料中表现突出，有望为后摩尔时代自主可控芯片技术提供关键材料支撑，并在二维半导体CMOS集成电路领域开辟新途径。

转为长期协议，三星和SK海力士将重置大型科技公司存储器合同

随着内存成为超大规模数据中心自主研发人工智能芯片和大规模基础设施建设的关键瓶颈，长期供应协议正迅速成为新的行业标准，其期限也比之前预期的更长。据Aju News 报道，三星和 SK 海力士正在逐步放弃与全球大型科技公司签订的一年期短期合同，转而采用为期三至五年的纯长期供应协议模式。

早于韩国同行，美光科技在3月份的财报电话会议上就已表示，已签署首份五年战略客户协议（SCA），并正与多家客户积极洽谈。据Aju News报道，三星电子已采取一项新政策，自今年起，所有新合同均需签订至少三年的长期协议（LTA）。

值得注意的是，Aju News指出，三星有望与包括AMD、微软和谷歌在内的几家主要客户达成稳定的三年内内存供应协议，这些客户目前正处于谈判后期阶段。Aju News还指出，尽管三星此前一直接受超短期协议（甚至按季度签订），但该公司现在已决定将其供应框架过渡到基于长期协议（LTA）的模式。

与此同时，据了解，SK海力士也在与谷歌洽谈一项为期五年的DRAM长期供应协议。据Aju News报道，双方的讨论还包括将协议延长两年，前提是下一代HBM的供应能够到位，因为SK海力士目前是谷歌HBM3E的主要供应商。报道还指出，谈判最初预计将于今年晚些时候完成，但现在看来很可能在今年上半年就达成协议。

据《韩京报》报道，SK海力士与微软就一项多年期DDR5长期供应协议的协调工作也已进入最后阶段。该协议价值数万亿韩元，预计将从今年开始生效，为期三年。

三星电子2026年Q1业绩指引创历史新高

4月7日，三星电子（Samsung Electronics）正式发布2026年第一季度未经审计业绩指引，交出史上最强单季成绩单。数据显示，一季度合并销售额约133万亿韩元（约合人民币6065亿元），同比增长68.1%；合并营业利润约57.2万亿韩元（约合人民币2611亿元），同比暴增755%，远超市场预期。

本次业绩指引基于韩国国际财务报告准则（K-IFRS），盈利区间为57.1万亿-57.3万亿韩元，中位数达57.2万亿韩元。值得关注的是，一季度营业利润已超越2025年全年43.6万亿韩元的水平，较2025年第四季度20.07万亿韩元环比增长185%，创下韩国企业单季盈利新纪录。

业绩爆发核心源于AI驱动的存储芯片需求激增。受AI服务器产能持续抢购影响，HBM、DRAM、NAND闪存量价齐升，三星作为全球存储龙头，HBM业务营收同比增超300%，存储部门成为绝对利润主力。公司高端产能向高附加值产品倾斜，老旧产线收缩策略成效显著，毛利率持续攀升。

三星明确，本次为初步业绩指引，完整财报（含净利润、部门明细、毛利率及电话会）将于4月23日发布。业内分析认为，AI算力需求长期旺盛，存储芯片涨价周期有望延续至2026年下半年，三星盈利或维持高位运行。

2025年全球半导体设备市场：中国大陆支出居第一，中国台湾增速最高

当地时间4月7日，国际半导体产业协会（SEMI）发布最新报告称，2025年全球半导体制造设备销售额达到1351亿美元，较2024年的1171亿美元增长15%，连续第三年创下历史新高。这一数据较SEMI在2025年12月发布的1330亿美元预测值上修了约1.6%，反映出AI需求在2025年四季度末仍保持超预期增长态势。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示：“2025年创纪录的半导体设备账单达到1350亿美元，凸显了随着人工智能加速对前沿逻辑、先进内存和高带宽架构需求的推动，行业建设的规模和紧迫性。从晶圆制造投资到先进封装和测试的快速发展，全球生态系统正在扩展能力和能力，以支持下一波创新浪潮。”

展望2026年，SEMI在2025年12月发布的预测报告中曾预计，全球半导体设备销售额将继续增长至1450亿美元，2027年进一步攀升至1560亿美元，连续三年刷新历史纪录。

增长的核心驱动力将来自三个方面：一是台积电、三星、英特尔在2nm及以下节点的资本开支竞赛；二是HBM产能扩张，三星、SK海力士、美光均计划在2026年大幅扩产HBM产线；三是先进封装产能紧缺持续，台积电CoWoS、三星I-Cube等封装技术的产能扩张将带动相关设备需求。

不过，行业也面临潜在风险。美国拟推出的MATCH Act若通过，可能进一步限制对华先进设备出口，影响全球设备供应链；此外，AI投资若出现阶段性降温，也可能导致设备订单波动。

联电公布2026年3月及一季度营收 一季度营收突破600亿新台币

4月8日，晶圆代工大厂联华电子正式公布2026年3月份合并营收报告，核心经营数据表现亮眼，一季度营收成功突破市场预期。

公告数据显示，联电2026年3月份合并营收达新台币208.3亿元，较2025年同期的新台币198.6亿元成长4.89%，单月营收保持稳健增长态势。从季度表现来看，2026年第一季度联电累计合并营收达到新台币610.37亿元，较2025年同期的新台币578.6亿元年增5.49%，成功突破先前市场普遍预估的600亿元大关，展现出强劲的经营韧性。

作为全球知名晶圆代工厂商，联电专注于集成电路制造服务，业务涵盖逻辑芯片、电源管理芯片、射频芯片等多个领域，其营收表现与全球半导体产业景气度密切相关。此次一季度营收超预期，得益于公司差异化经营策略，尤其是在成熟制程领域的稳定需求支撑。

公开信息显示，联电此前在2025年第二季财报中就曾提及，22/28纳米晶圆营收占比已提升至40%，创下历史新高，该制程领域的强劲需求成为公司营收增长的重要动力。结合此次营收数据来看，成熟制程的持续发力，有效对冲了行业波动影响，推动公司营收稳步增长。

总投资20亿元 三菲化合物半导体光芯片制造基地项目落户太仓

4月8日，三菲化合物半导体光芯片制造基地项目正式签约落户江苏省太仓市城厢镇，项目计划总投资达20亿元，将聚焦化合物半导体光芯片研发与制造，填补区域相关产业空白，助力太仓打造半导体产业集群。

化合物半导体光芯片是光通信、5G通信、人工智能、物联网等新兴领域的核心元器件，市场需求持续攀升，也是我国半导体产业自主可控的关键环节。此次落户的三菲化合物半导体光芯片制造基地项目，将分两期推进建设，其中一期项目总投资10亿元，预计于2026年8月正式开工建设，2028年实现投产运营，达产后可实现年产值超10亿元，进一步完善国内化合物半导体光芯片产业链布局。

作为项目落户地，太仓市在半导体产业领域具备良好的产业基础和区位优势，近年来持续聚焦集成电路、半导体等战略性新兴产业，通过完善配套设施、优化营商环境，吸引了一批优质半导体项目集聚。此次三菲化合物半导体项目的落户，将进一步丰富太仓半导体产业生态，推动产业向高端化、精细化升级，提升区域半导体产业核心竞争力。

公开信息显示，三菲半导体在光芯片领域拥有深厚的技术积累，此前曾参与临港产业区钻石园相关项目签约，聚焦光芯片IDM领域布局。此次在太仓投资建设制造基地，是企业扩大产能、拓展市场的重要举措，将依托太仓的产业优势和政策支持，打造集研发、生产、测试于一体的化合物半导体光芯片产业基地。

业内人士表示，当前我国化合物半导体产业正处于快速发展期，三菲化合物半导体光芯片制造基地项目的落地，不仅将助力企业抢占市场先机，更将带动上下游配套产业集聚，推动我国化合物半导体光芯片领域的技术进步和产能提升，为半导体产业自主可控注入新动力。

太仓市相关负责人表示，将全力做好项目服务保障工作，协调解决项目建设、投产过程中的各类问题，为项目顺利推进保驾护航，推动项目早日建成见效，助力区域半导体产业高质量发展。

韩美半导体将推出第二代混合键合机原型

4月9日，韩美半导体（Hanmi Semiconductor）正式对外披露，公司计划于2026年内推出用于下一代高带宽内存（HBM）生产的“第二代混合键合机”原型机，并同步启动与客户合作验证。此外，公司还明确规划，将于2027年上半年启动混合键合机专用工厂的运营。

作为全球HBM热压键合机市场的领先企业，韩美半导体此次布局旨在抢占下一代HBM封装设备的技术制高点。混合键合技术通过铜-铜直接键合取代传统焊料凸块，可大幅提升芯片互连密度、数据传输速度并降低功耗，是实现20层及以上高层数HBM量产的关键技术，也是AI算力爆发背景下半导体设备领域的核心竞争方向。

韩美半导体早在2020年就推出了第一代HBM混合键合机，积累了丰富的技术研发与验证经验。此次即将推出的第二代原型机，整合了初代设备的技术优势，在纳米级精度、工艺稳定性和产能 yield 等方面实现全面升级，其对准精度可达 ± 100 纳米，可对标全球行业标杆水平，适配下一代HBM芯片面积扩大、堆叠层数增加的发展需求。

在产能布局方面，韩美半导体已启动混合键合机工厂建设，该工厂位于韩国仁川 Juan 国家工业园区，总投资达1000亿韩元（约合3400万美元），建筑面积14570平方米，将配备顶级的100级洁净室，以满足纳米级超精密制造需求，计划2027年上半年正式投产运营。

当前，韩美半导体在全球HBM热压键合机市场占据71.2%的主导份额，核心客户包括SK海力士等头部存储厂商。此次推出第二代混合键合机并布局专用工厂，是公司“巩固现有优势、抢占未来赛道”的双线战略体现，既能衔接当下HBM技术迭代需求，也为2029年混合键合技术大规模量产做好准备，将进一步强化其在半导体设备领域的市场地位，助力全球HBM产业升级。

Nippon Shokubai宣布扩产半导体材料

4月9日消息，据《日经新闻》报道，受益于人工智能（AI）普及所带动的需求攀升，日本材料大厂Nippon Shokubai（日本触媒）宣布将投资数十亿日元，通过姬路制作所（兵库县姬路市）扩增产线，以增产半导体封装等“后段制程”所需的半导体材料。

报道称，Nippon Shokubai将从2026年度起，在姬路制作所增产多项半导体材料，其中最核心的产品为“二氧化硅（Silica）微粒子”。该材料的主要作用是抑制填补芯片和载板间隙的树脂因受热而膨胀，是先进半导体封装工艺中的关键材料之一。

Nippon Shokubai电子与环境解决方案事业部副部长岩井邦浩表示：“半导体高性能化，带动了需求的增长。”他指出，随着AI芯片性能持续提升，单一载板上搭载的芯片数量不断增加，这对封装材料的散热和稳定性提出了更高要求，从而推动了“二氧化硅微粒子”订单的增长。

Nippon Shokubai已将半导体相关材料定位为“解决方案事业”的核心增长领域。根据公司2025年发布的中期经营计划，公司正集中资源进行业务组合转型，将重点投资于特种化学品、电子材料和电池等高增长领域。

Nippon Shokubai表示，其半导体材料等“电子材料事业”业绩稳健，计划在2027年度将获利提高至65亿日元，较2024年度暴增80%。公司正以2030年为远景目标，力争在2027财年实现营业利润350亿日元、ROE超过7%的经营目标。

在半导体材料领域，Nippon Shokubai利用其在显示材料领域积累的光学控制和微粒子设计技术，持续开发用于先进封装的新材料。公司计划通过扩大半导体和电池等高增长领域的业务，推动盈利能力的持续提升。

04 公 司 公 告

研究创造价值

海光信息:关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

一、权益变动触及1%刻度的基本情况

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日收到股东成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝海轻舟合伙”）出具的《关于股东权益变动的告知函》，蓝海轻舟合伙于2026年4月8日通过大宗交易方式减持所持有公司股份2,091,900股。减持后，蓝海轻舟合伙持有公司股份139,394,464股，占公司总股本的6.00%。蓝海轻舟合伙所持公司股份比例由6.09%减少至6.00%，触及1%的整数倍。

二、其他说明

1、本次权益变动为蓝海轻舟合伙履行此前披露的减持计划，具体内容详见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-002）。本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致，截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

2、公司无控股股东、无实际控制人，本次权益变动不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、公司将督促信息披露义务人严格执行减持相关规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

天德钰:关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币25亿元。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2026年4月8日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币25亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。

该授信有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或股东大会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，拟授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。

中科蓝讯:关于公司2025年度利润分配预案的公告

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,203,622,630.55元，资本公积为2,891,248,990.79元。经公司第二届董事会第二十五次会议审议，公司2025年度的利润分配预案如下：截至本公告披露日，公司总股本为120,598,200股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币20元（含税），合计拟派发现金红利人民币241,196,400.00元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润17.04%。以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，合计转增57,887,136股，转增后公司总股本变更为178,485,336股。不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

航宇微:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（大华审字[2026]0011004154号），截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,302,883,947.77元，未弥补亏损金额为-1,302,883,947.77元，实收股本为696,874,323.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、亏损原因

报告期内，公司根据企业会计准则和相关政策规定，对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等进行减值测试，计提了相应的资产减值准备；对应收账款回款风险审慎地进行评估，计提了相应的坏账准备。根据盈利预测及研发加计扣除政策税法计算可抵扣弥补亏损，冲回部分以前年度确认的递延所得税资产。

长电科技:关于公司会计政策变更的公告

一、会计政策变更情况概述

本次会计政策变更是江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的合理变更，无需公司董事会和股东会审议，不会对公司本期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）本次会计政策变更原因及变更日期

财政部于2025年12月5日颁布了《解释19号》，本解释“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的规定，自2026年1月1日起施行。

（二）变更前采取的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释19号》的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

力芯微:关于开展外汇衍生品交易的公告

公司于2026年4月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司的外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展总额度不超过人民币2亿美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币3,000万美元（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币600万美元。

本次交易的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施相关事宜。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对本次拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。

华天科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年3月19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007号]（以下简称“《审核问询函》”）。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项说明、论证和回复，并对本次交易草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》等文件。

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并根据本次交易的进展情况严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责条款

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券

CHINA FORTUNE SECURITIES

研 究 创 造 价 值